ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОЛУПРОВОДНИКИ Трафаретная печать

О1 Трафаретная печать Сборка микросхем

ОЗ Крепление контактов

О4 Крепление кристалла к подложке

16 Высокоточный манипулятор с вращательным механизмом

17 Захват, выравнивание распределение

20 Перемещение подложки

21 Усовершенствование чип-тестера

22 2x-осевой позиционер 23 Маркировочная машина

Лазерная система контроля

48 Клеевые станции

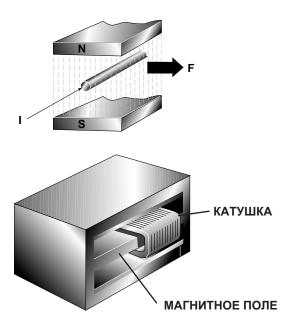
32

50 Позиционер XY **51** Очищение подложки

52 Монтаж методом перевернутого кристалла

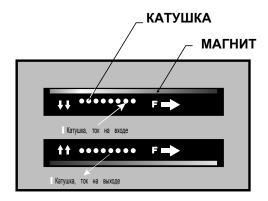
53 Закрутка конденсатора

ТЕХНОЛОГИЯ С ПОДВИЖНОЙ КАТУШКОЙ



Сила прямо пропорциональна **N I B**, где:

- **N** число витков катушки;
- I электрический ток, проходящий через катушку;
- В магнитные потоки



Электрический ток (I) циркулирует в катушке Линии индукции(B) Сила (F)

F = n I B

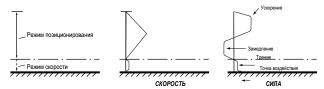


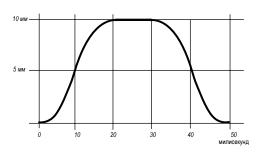
ТЕХНОЛОГИЯ С ПОДВИЖНОЙ КАТУШКОЙ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ





Ускорение
$$a = \frac{2s}{t^2} = \frac{2x5}{100} \times 10^6$$

$$= 10 \times 10^4 \frac{\text{MM}}{\text{CeK}}_2$$

$$= 10 \text{ r}$$

Скорость
$$max = at = 10^5 \times \frac{10}{10^3} = 1$$
 м/сек

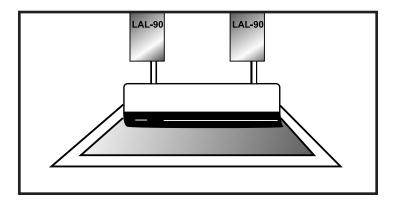
Трафаретная печать

Качество печати зависит от положения печатных валов, которыми управляют цилиндры;

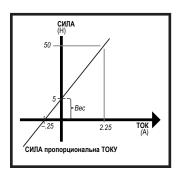
В процессе печати резиновый валик может менять положение, в таком случае цилиндры, расположенные с обоих концов, должны скорректировать его положение и его давление на печатную форму. Таким образом, цилиндры гарантируют фиксированное положения печатного вала



Печатные платы







Цилиндр:□ LAL-90

Рабочий ход (мм): 15,50 Точность: 1 до 5 микрон Сила: 100 Н

Сила: 100 H Масса: 250 гр Напряжение: 48 В

Ход□ работы:

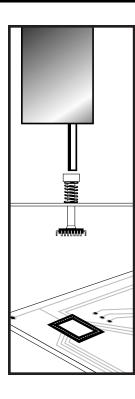
Положение печатного вала определяется двумя цилиндрами, которые автоматически корректируют его положение и его давление на печатную форму при отклонении от заданных параметров;

Цилиндры имеют единый блок управления и, при изменениях одного - автоматически корректируется положение и работа другого;

Погрешность в управлении цилиндрами составляет +/- 5 импульсов

Преимущества□ SMAC:

Возможность управления положением цилиндров при силовом режиме и быстрое переключение режимов



Сборка микросхем

Перемещение деталей на высокой скорости;

Большинство аппаратов для сборки микросхем состоят из механических кулачковых механизмов и пружин;

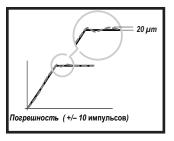
Для обработки 10 элементов в секунду (100 мсек/эл), поршень цилиндра должен быть остановлен в верхнем/нижнем положении каждые 30 мсек;

Цилиндр должен обладать высокой износостойкостью и большим ускорением. (напр.: *LAL-90*)

Другие □ применения:

Печатные платы





Цилиндр: LAL-90

Рабочий ход (мм): 15,50 Точность: 1 до 5 микрон Сила: 100 Н Масса: 250 гр Напряжение: 48 В

Ход работы:

Выдвижение штока цилиндра (для установки микросхемы на плату) и фиксация элемента (требуемое время: 30 мсек);

Задержка в этом положении 30 мсек;

Втягивание штока, 30 мсек;

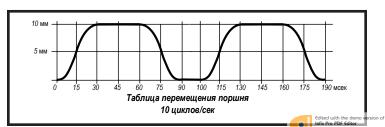
Захват следующего элемента (10 мсек)

Преимущества SMAC:

Высокая изностойкость, цилиндры выдерживают большие нагрузки, программирование под требования определенного клиента;

Точность позиционирования до 20 микрон;

Отдельное программирование ПИД-регулятора (при рабочем ходе вниз - сопротивление пружины)



Крепление контакта

A. 3AXBAT KOHTAKTA

- Высокая скорость в начале цикла;
- Замедление, аккуратное приземление на микросхему

В. РАБОТА С ТЕРМОКЛЕЕМ

- Увеличение скорости, контроль за положением контакта при пайке;
- Поддержание силы на уровне 250-500 гр;
- Фиксация

С. КОНЕЦ ЦИКЛА

• Высокая скорость





ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Время ОТКОРЕНИЕ Треше Т

Цилиндр: LAL-90

Рабочий ход (мм): 15,50 Точность: 1 до 5 микрон

Сила: 100 H Масса: 250 гр Напряжение: 48 B

Ход работы:

Высокая скорость в начале цикла, аккуратное приземление на рабочую поверхность;

Увеличение скорости, контроль за положением контакта при пайке;

Поддержание силы на уровне 250-500 гр;

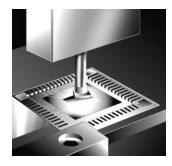
Высокая скорость при втягивании штока на конечном этапе цикла

Преимущества SMAC:

Быстрая смена режимов;

Возможность управления положением при силовом режиме





Крепление кристалла

A. 3AXBAT

- Высокая скорость в начале цикла;
- Замедление, аккуратное приземление на элемент;
- Переключение на вакуумный режим, подбор элемента;
- Высокая скорость перемещения

В. ВЫРАВНИВАНИЕ

- Камера фиксирует положение;
- Цилиндр приводит элемент в необходимое положение

С. ФИКСАЦИЯ

- Высокая скорость;
- Замедление, аккуратное приземление на подложку;
- Увеличение силы и фиксация элемента:
- Высокая скорость в конце цикла



ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Парасителена па режиму спереда от пределение УСКОРЕНИЕ СВЛА СВЛА

ЗАМЕДЛЕНИЕ

Цилиндр: LAR-30

Рабочий ход (мм): 15,25 Точность: 1 до 5 микрон Сила: 10 Н

Сила: 10 H Macca: 210 гр

Ось вращения: точность 0,07°

Напряжение: 24 В

Ход□ работы:

Высокая скорость в начале цикла, замедление, аккуратное приземление на рабочую поверхность, переключение на вакуумный режим, захват элемента, высокая скорость перемещения;

Камера фиксирует положение, цилиндр приводит элемент в необходимое положение:

Аккуратное приземление на подложку, увеличение силы и фиксация элемента

Преимущества SMAC:

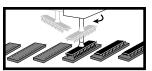
Использование цилиндра *Z-Theta* в удобной и компактной сборке, готовой к эксплуатации;

Высокая скорость и длительный срок службы (от 200 до 700 млн. циклов);

Многофункциональность, программирование для перемещения хрупких элементов



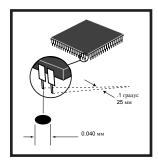
Высокоточный манипулятор с вращательным механизмом



- Датчик поворота имеет характеристики 50,000 импульсов/оборот точность до 0,0072°:
- Датчик поворота установлен на выходной вал, отсутствие зазора;
- Скорость переключения 5500 rmp;
- Вращение по оси с ускорением 6-G

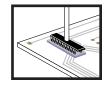
Другие применениям

Захват, выравнивание и распределение многочиповых модулей; Корпус с матрицей штырьковых выводов













Рабочий ход (мм): 40 Точность: 1 до 5 микрон Сила: 30 Н Масса: 500 гр

Ось вращения: точность до 0,0072° Момент силы: 0,03 Н/м Напряжение: 24 В

Ход□ работы:

Высокая скорость в начале цикла, замедление, аккуратное приземление на чип, переключение на вакуумный режим, подбор элемента, высокая скорость перемещения;

Камера фиксирует положение, цилиндр приводит элемент в необходимое положение;

Преимущества ☐ SMAC:

Прямой привод с датчиком поворота (50,000 импульсов/оборот);

Использование цилиндра *Z-Theta* в удобной и компактной сборке, готовой к эксплуатации;

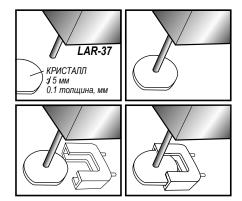
Высокая скорость и длительный срок службы (от 200 до 700 млн. циклов);

Многофункциональность, программирование для перемещения хрупких элементов



Подбор, выравнивание, распределение

- Кварцевые кристаллы для процессоров мобильных телефонов - маленькие и хрупкие элементы и их крепление к подложке происходит в чистой комнате;
- Производительность цилиндра SMAC LAR-37 1000 дет/час





ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Перескночение и режиму режиму деновате и режиму деновате ускропные Тронке Тронк

Цилиндры LAR-37

Рабочий ход (мм): 50 Точность: 1 до 5 микрон Сила: 10 Н Масса: 250 гр Ось вращения: точность до 0,072° Момент силы: 0,1 Н/м Напряжение: 24 В

Ход работы:

Высокая скорость в начале цикла, замедление, аккуратное приземление на рабочую поверхность, переключение на вакуумный режим, захватэлемента, высокая скорость перемещения:

Камера фиксирует положение, цилиндр приводит элемент в необходимое положение;

Присоединение кристалла к подложке

Преимущества SMAC:

Использование цилиндра *Z-Theta* в удобной и компактной сборке, готовой к эксплуатации;

Высокая скорость и длительный срок службы;

Многофункциональность, программирование для перемещения хрупких элементов

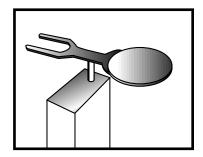
Чувствительность штока менее 20 микрон, что обеспечивает хорошее соединение



Перемещение подложки

При помощи манипулятора подложки переносят с одного участка производства на другой;

Сила действия на подложку чувствительна до 10 грамм





Цилиндр: LAR-50 (специальная модификация с шаговым двигателем)

Рабочий ход (мм): 50 Точность: 1 до 5 микрон Сила: 25 Н Масса: 500 гр Напряжение: 24 В Ось вращения: шаговый двигатель

Ход работы:

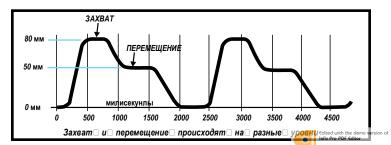
Подбор подложки и поворот на 180°;

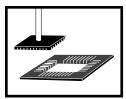
Перемещение подложки

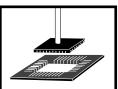
Преимущества SMAC:

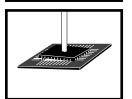
Возможность быстрого программирования под требования клиента;

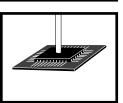
Сила действия на подложку чувствительна до 10 грамм











Усовершнствование чип-тестера

СТАРОЕ РЕШЕНИЕ:

- Пневматический цилиндр автоматически вставляет чипы в тестер;
- Корректировка положения чипа в тестере;
- Контактор изнашивается спустя короткий промежуток времени;
- Отбракованные чипы проходят тестирование второй

новое решение:

Цилиндры SMAC устанавливают чипы в тестер:

- Перемещение чипа в начальное положение (высокие скорости):
- Установка контактора на низких скоростях (низкий импульс):
- Аккуратное приземление на контактор;
- Проверка положения контактора:
- При силе действия выше допуска происходит сброс и цикл начинается заново (контактор не поврежден);
- При силе действия в допуске происходит проверка. расположения чипа;
- При правильном положении начинается тест:
- При неправильном положение, отмена цикла

Другие применения:

Подключение генератора к печатной плате;

Подключение крохотной печатной платы к тестеру;

Подключение к предохранителю;

Подключение тензометра к печатной плате





ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Переключени СИЛА время замелление.

Цилиндр: LAL-бТ

Рабочий ход (мм): 25 Точность: 1 до 5 микрон Сипа: 10 Н Масса: 150 гр Напряжение: 24 В

работы:

Высокая скорость в начале цикла. замедление и выдвижение штока, аккуратное приземление на рабочую поверхность, определение правильного расположения элемента:

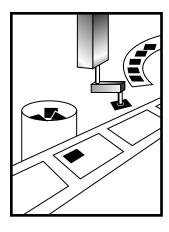
Сила увеличивается постепенно. положение и сила действия цилиндра измеряется для определения правильной установки элемента

Преимущества SMAC:

Управление сипой отслеживание положения контактора при подключении не изнашивает его;

Защита контактора от разрушения и отличные результаты при проведении тестов





2х-осевые манипуляторы

- Подбор бракованного чипа с конвейера и перемещение его к отбракованным элементам;
- Перемещение к линии с чипами, подбор нового чипа:
- В случае, если чип не был отбракован возврат на конвейерную ленту

Другие применения:

Тестирование чипов;

Крепление кристаллов;

Лоточная упаковка



Цилиндр: LAR-30

Рабочий ход (мм): 25 Точность: 1 до 5 микрон Сила 10 Н Масса: 210 гр Ось вращения: точность 0.072° Момент силы: 0.1 Н/м Напряжение: 24 В

Ход работы:

Высокая скорость в начале цикла, замедление и выдвижение штока, аккуратное приземление на рабочую поверхность, переключение на вакуумный режим; подбор элемента, высокая скорость перемещения;

Перемещение с вращением для установки элемента

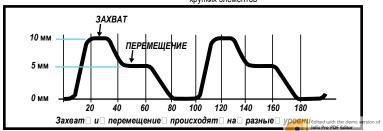
Преимущества SMAC:

Подъем и транспортировка деталей с использованием цилиндра *Z-Theta* в удобной и компактной сборке, готовой к эксплуатации;

Высокая скорость и длительный срок службы (от 200 до 700 млн. циклов);

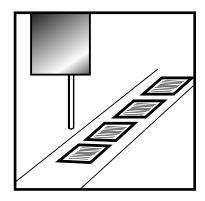
To remove this notice, visit: www.iceni.com/unlock.htm

Многофункциональность, программирование для перемещения хрупких элементов



Маркировочная машина

Подъемно-транспортные операции; Вакуумное присасывание для захвата; Программирование согласно требованиям клиента для наклейки этикеток





Цилиндр: LAL-бТ

Рабочий ход (мм): 25 Точность: 1 до 5 микрон

Сила: 10 H Масса: 150 гр Напряженние: 24 B

Ход работы:

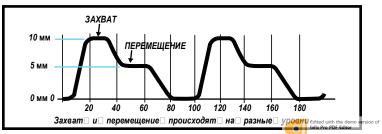
Высокая скорость в начале цикла, замедление выдвижение штока, переключение на вакуумный режим;

Отделение этикетки от поверхности, управление скоростью перемещения, чтобы не потерять контакт с этикеткой;

Наклейка этикетки

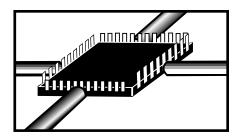
Преимущства SMAC:

Управление скоростью и силой для отделения этикетки от липкой подложки



Лазерная система контроля

Цилиндры SMAC с технологией подвижной катушки используются в лазерной системе контроля для определения правильного положения микросхем, различных по размеру, при установке





ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Переспочение на режим управления спростью Треше СИЛА ВРЕМЯ Замядляние парежим управления паре

Цилиндр: LAL-30 (мод. пониженное трение)

Рабочий ход (мм): 15,25 Точность: 1 до 5 микрон

Сила: 15 Н

Масса объекта: 150 гр Напряжение: 24 В

Цилиндр: LAR-40

Рабочий ход (мм): 40 Точность: 1 до 5 микрон Сила: 30 Н Масса объекта: 150 гр Ось вращения: точность 0,0072° Момент силы: 0.03 Н/м

Момент силы: 0,03 H/м Напряжение: 48 В

Ход работы:

Высокая скорость в начале цикла, замедление, аккуратное приземление на рабочую поверхность, переключение на вакуумный режим, захват элемента;

Камера фиксирует положение, цилиндр приводит элемент в необходимое положение

Преимущества SMAC:

Прямой привод с датчиком поворота (50,000 импульсов/оборот);

Использование цилиндра *Z-Theta* в удобной и компактной сборке, готовой к эксплуатации;

Высокая скорость и длительный срок службы (от 200 до 700 млн. циклов);

Многофункциональность, программирование для перемещения хрупких элементов;

Точность до 1 микрона



Клеевые станции

Дозировка клея на рабочую поверхность. Клеевые точки должны быть абсолютно равными по форме и размеру в соответствии с заданными параметрами. Такая точность достигается благодаря оптимальному расположению дозатора. Поверхность гибкой монтажной платы волнистая.

Решение:

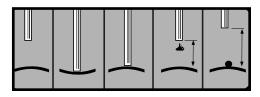
- 1. Подбор оптимального расстояния между дозатором и поверхностью;
- 2. Позиционирование над поверхностью;
- 3. Распределение клея или пастообразных материалов;

Ход□ работы:

- 1. Начало цикла на расстоянии 10 мм от рабочей поверхности;
- 2. Быстрое сближение с поверхностью до 1 мм;
- 3. Аккуратное приземление на рабочую поверхность;
- 4. Уменьшение давление штока для образования волнистой поверхности;
- 5. Подъем от поверхности (напр. на 0,5 мм);
- Нанесение в течение определенного времени клея или пастообразных материалов;
- 7. Подъем на 10 мм от поверхности для начала нового цикла;

Старое решение: 3 точки в секунду;

Решение SMAC: 5 точек в секунду





ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Дамая Пересалогиен из режим уруждения УСКОРЕНИЯ Точка воздабетия Дересалогиен и режим управления Дересалогиен и режим управления дересалогиен и преми управления дересалогиен дересалогиен

Цилиндр: LAL-30 (мод. пониженное трение)

Рабочий ход (мм): 15,25 Точность: 1 до 5 микрон Сила: 15 Н Масса объекта: 150 гр Напряжение: 24 В

Ход□ работы:

Высокая скорость в начале цикла, замедление, аккуратное приземление на рабочую поверхность;

Переключение на силовой режим для уменьшения давления штока для позиционирования дозатора;

Подъем от поверхности на необходимое расстояние для распределения клея или пастообразных материалов;

Преимущества SMAC:

Цилиндр в удобной и компактной сборке, готовой к эксплуатации;

Высокая скорость и длительный срок службы (от 200 до 700 млн. циклов);

Возможность постоянно контролировать силу



Масса объекта: 250 гр

Ось-Ү:

Рабочий ход: 25 мм Точность: 1 до 5 микрон Сипа: 80 Н

Масса объекта: 1 250 кг

Ход□ работы:

Высокоскоростной сервопозиционер

www.iceni.com/unlock.htm

Преимущества SMAC:

Высокая скорость; Минимальное трение

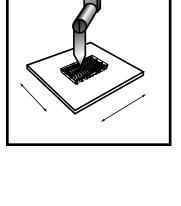
Позиционер Х-Ү

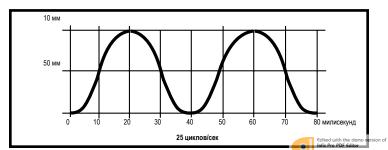
- Высокая скорость и точность позиционирования;
- Стандартаня точность микрон, максимально доступная для программирования 1 микрон;
- Длительный срок службы (от 200 до 700 млн. циклов), технология с подвижной катушкой;

Применение:

Крепление контактов При движении 0,5 мм - 4 мсек; При движении 2 мм - 9 мсек; Крепление разъемов





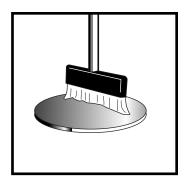


Очищение подложки

- Щеточка аккуратно приземляется на подложку;
- Контактное усилие поддерживается на протяжении всего цикле на уровне 10 гр;
- Контроль силы, а не положения;

Другие применения:

Полировка подложки





СИЛА (МН)

10,000 — Вес деижущихся единиц

ТОК (мА)

СИЛА прямо пропорциональна ТОКУ

Цилиндр: □ LAR-50

(специальная □ модификация □ с шаговым □ двигателем)

> Рабочий ход (мм): 50 Точность: 1 до 5 микрон

Сила: 25 Н

Масса объекта: 500 гр Напряжение: 24 В

Ось вращения: шаговый двигатель

Ход□ работы:

Подъем подложки до уровня щетки;

Переключение на силовой режим для поддержания контактного усилия на уровне 10 гр;

Вращение щеточки и очищение поверхности;

Преимущества ☐ SMAC:

Возможность программирования силового режима ниже 10 гр;



Монтаж методом перевернутого кристалла



Технологии в микроэлектронике направлены на увеличение плотности интеграции компонентов, увеличение функциональных способностей таких чипов и уменьшение их размеров.

Производство микрочилов методом перевернутого кристалла может быть выполнено с использованием различных технологий: ESC, ACFC, CPC and C4. Такие технологии беспроволочных соединений позволяют исключить некоторые эталы производства.

Для обеспечения надежности соединения, контактные усилия должны быть приложены с высокой точностью.

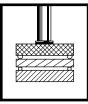
Цилиндры SMAC управляются непосредственно благодаря технологии подвижной катушки, что позволяет контролировать контактное усилие до 10 гр и совершать эффективные подъемно-транспорные операции с хрупкими микрочипами. После позиционирования всех элементов, сила может быть значительно увеличена для обеспечения необходимого давления во время процесса формирования микрочипа.



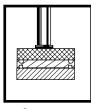


Другие□ применения:

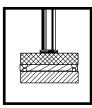
Kopnyc BGA



Монтаж методом перевернутого кристалла



Замыкание контакта



Формирование под давлением



Цилиндр: LAR-40

Цилиндр (мм): 40 Точность: 1 до 5 микрон Сила: 30 Н

Масса :500 гр

Ось вращения: точность до 0,0072°

Момент силы: 0,03H/м Прямой привод Напряжение: 48 В

Ход □ работы:

Высокая скорость в начале цикла, замедление, аккуратное приземление на микрочип, переключение на вакуумный режим, захват элемента, высокая скорость перемещения:

Камера фиксирует положение, цилиндр приводит элемент в необходимое положение:

Аккуратное приземление на плату, увеличение скорости, фиксация положения, вулканизация под давлением

Преимущества □ SMAC:

Высокая точность перемещения для обеспечения эффективной работы;

Прямой привод (отсутствие люфта);

Использование цилиндра Z-Theta в удобной и компактной сборке, готовой к эксплуатации;

Высокая скорость и длительный срок службы (от 200 до 700 млн. циклов);

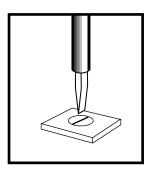
Программирование для перемещения хрупких элементов;

Чувствительность штока менее 20 микрон, что обеспечивает коро Шеег with the demo version of соединение

To remove this notice, visit:



Закрутка конденсаторов



Конденсаторы используются в аппаратуре. При прикосновении или приближении какого-либо объекта емкость конденсатора изменяется, поэтому их закручивают 1 раз;

Чувствительное оборудование SMAC применяется при закрутке (чувствительность менее 30 гр)

Дополнительно:

Специальный режим позволяет не применять силу во время процесса настройки

Другие применения:

Калибровка и настройка термостатов: Регулировка переменных резисторов



ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАМЕЛЛЕНИЕ

Цилиндр: LAR-37

Рабочий ход (мм): 50 Точность: 1 до 5 микрон Сила: 10 Н Масса объекта: 250 гр Ось вращения: точность 0,072° Момент силы: 0,1 Н/м Напряжение: 24 В

работы:

Высокая скорость в начале цикла, замедление, аккуратное приземление на проводник;

Уменьшение силы воздействия, вращение до тех пор, пока наконечник не попадет в шлиц под отвертку;

Для приложения нулевой силы на обкладку конденсатора во время настройки, наконечник с отверткой на половину входит в шлиц;

Вращение наконечника и закрутка;

Возврат в начальное положение:

При неверном приземлении в шлиц, любое движение может изменить емкость конденсатора. В таком случае сенсор чувствительности подает сигнал, если можно начинать рабочий процесс:

Преимущества SMAC:

Программирование для перемещения хрупких элементов:

Чувствительность штока менее 20 микрон, что обеспечивает хорошее соединение:

НУЛЕВОЙ СИЛЫ ВО ВРЕМЯ PROTOStemove this notice, visit:

